

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-171972

(43)Date of publication of application : 23.06.2000

(51)Int.Cl.

G03F 7/027
H05K 3/00

(21)Application number : 10-345047

(71)Applicant : KANSAI PAINT CO LTD

(22)Date of filing : 04.12.1998

(72)Inventor : KOJIMA DAISUKE
IMAI GENJI
AKUI JUN
KOGURE HIDEO
ISOZAKI OSAMU

(54) LIQUID STATE PHOTOSENSITIVE COMPOSITION, AQUEOUS PHOTOSENSITIVE COMPOSITION AND PATTERN FORMING METHOD USING THESE COMPOSITIONS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance alkali developability and etching resistance and the like and to enable a minute pattern to be formed by incorporating a specified photopolymerizable urethane compound.

SOLUTION: The photosensitive compositions contain the polyurethane compound having structural units each represented by the formula. B-[X]_n[Y]_m-B, and when needed, another photopolymerizable compound, and in the formula, Y is represented by -OOCN-A-NHC₂H₅OOC-(R₂)-, A is a structural unit derived from a polyisocyanate compound, B is a structural unit derived from a hydroxyl compound having ether bonds having one or more photopolymerizable unsaturated groups on each end, R₁ is a structural units derived from a polyol compound having a carboxyl group; and each of (n) and (m) is an integer of 1-10.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.12.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-171972

(P2000-171972A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51)Int.Cl.⁷

G 0 3 F 7/027
H 0 5 K 3/00

識別記号

5 1 3

F I

G 0 3 F 7/027
H 0 5 K 3/00

テマコード(参考)

5 1 3 2 H 0 2 5
F

審査請求 未請求 請求項の数3 O.L (全15頁)

(21)出願番号

特願平10-345047

(71)出願人 000001409

関西ペイント株式会社

兵庫県尼崎市神崎町33番1号

(22)出願日 平成10年12月4日(1998.12.4)

(72)発明者 小嶋 大輔

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

(72)発明者 今井 玄児

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

(72)発明者 阿久井 潤

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液状感光性組成物、水系感光性組成物及びそれらの組成物を使用したパターン形成方法

(57)【要約】

【課題】 感光性組成物及びパターン形成方法を提供す
る。

応じて上記した以外の光重合性化合物を含有することを
特徴とする液状感光性組成物。

【解決手段】 分子中に下記した構成単位

B-[X]_n[Y]_m-B

(式中、Xは式

【化6】



、及びYは-00CHN-A-NHC00-(R2)-で表され、Aはポリイ
ソシアネート化合物に由来する構造単位、Bは同一もし
くは異なってそれぞれの分子末端に1個以上の光重合性
不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロ
キシ化合物に由来する構造単位及びR1はカルボキシリ
基含有ポリオール化合物に由来する構造単位、R2はポ
リオール化合物に由来する構造単位を示す。nは1~1
0整数及びmは1~10の整数を示す。X及び/又はY
が2個以上の場合にはX及び/又はYは1個のものが相
互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わな
い。)を有する光重合性ポリウレタン化合物及び必要に

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子中に下記した構成単位

B-[X]_n[Y]_m-B

(式中、Xは式

【化1】



、及びYは-OOCHN-A-NHCOO-(R₂)-で表され、Aはポリイソシアネート化合物に由来する構造単位、Bは同一もしくは異なってそれぞれの分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロキシ化合物に由来する構造単位及びR₁はカルボキシリ含有ポリオール化合物に由来する構造単位、R₂はポリオール化合物に由来する構造単位を示す。nは1～10整数及びmは1～10の整数を示す。X及び/又はYが2個以上の場合にはX及び/又はYは1個のものが相互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わない。)を有する光重合性ポリウレタン化合物及び必要に応じて上記した以外の光重合性化合物を含有することを特徴とする液状感光性組成物。

【請求項2】 請求項1に記載の液状感光性組成物を分散してなることを特徴とする水系感光性組成物。

【請求項3】 (1) 基材上に請求項1又は請求項2に記載の感光性組成物を塗布して感光性被膜を形成する工程、(2) 基材上に形成された感光性被膜表面に所望の被膜(画像)が得られるようにレーザー光線で直接もしくは光線を用いてネガマスクを通して感光し、硬化させる工程、(3) 上記(2)工程で形成されたレジスト被膜をアルカリ現像処理して基板上にパターンを形成する工程、を含むパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液状感光性組成物及び水系感光性組成物に関し、特にプリント配線板製造用感光性組成物に関する。本発明の液状感光性組成物及び水系感光性組成物は、ソルダーレジスト、エッチングレジスト、耐メッキレジスト、UVインクなどに利用できる。

【0002】

【従来の技術およびその課題】従来、プリント配線基板などの導体回路を形成するため、感光性レジストを塗布した基板に、露光/現像によりレジストパターンを形成した後、エッチングにより不要部分を除去することが行われている。

【0003】このような感光性レジスト組成物としては、例えば、カルボン酸基を有する不飽和樹脂を用いて、希アルカリで現像できる感光性レジスト組成物(例えば特開平3-223759号公報参照)が公知である。

【0004】上記したカルボキシリ含有不飽和樹脂

は、通常、該公報にも記載されるようにアクリル酸のよいうな酸不飽和モノマーを(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとラジカル共重合反応させてポリカルボン酸樹脂を製造したのち、該樹脂とグリシジル(メタ)アクリレート等のエポキシ基含有不飽和モノマーとをカルボキシリ基(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーの一部とグリシジル基とを付加反応させることにより製造されている。

【0005】このような樹脂をアルカリ現像型レジスト組成物として使用した場合には、(1) ラジカル重合反応によるため、一般的には樹脂の分子量分布が広くなり、そのために高分子量域ではアルカリ現像液やエッチング液による溶解性が遅くなり、一方、低分子量域ではアルカリ現像液やエッチング液による溶解性が速くなり、均一な現像処理やエッチング処理を行うことができない、(2) (メタ)アクリル酸モノマー成分と(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとのラジカル共重合速度が同じでないのでアクリル酸モノマーのホモポリマーやアクリル酸成分が少ないアクリル樹脂成分ができたりするため、アルカリ現像処理によるレジスト被膜の除去速度が不均一となり、短い時間においてはレジスト被膜が残存し、また、エッチング液により、光硬化被膜が浸食されて洗い流されたりするため、微細なレジストパターンを形成することができない、(3) ポリカルボン酸樹脂とエポキシ基含有不飽和モノマーとを付加反応させる際に、加熱が行われるため、更にポリカルボン酸樹脂が高分子量化される、(4) また、該付加反応の際に不飽和基どうしのラジカル重合反応を抑制するために、通常、ラジカル重合禁止剤が配合されるがこのものが樹脂中に不要なものとして含まれるために光重合反応性が低下する、(5) 光硬化被膜の物性が十分でないためにエッチング液により該被膜部が浸食されて洗い流されたりするため微細なレジストパターンが形成できないといった問題点があった。

【0006】また、不飽和基を樹脂中に導入する方法として、上記した以外に、例えば、特開平7-102037号公報にポリヒドロキシ化合物、ラジカル重合性不飽和基含有ポリヒドロキシ化合物、陰イオン性親水基含有ポリヒドロキシ化合物、ポリイソシアネート化合物及びラジカル重合性不飽和基含有モノヒドロキシ化合物を反応させて得られるポリウレタン樹脂をアミンで中和してなる水溶性活性エネルギー線硬化型樹脂の製造方法が記載されている。しかしながら、上記した水溶性ポリウレタン樹脂をレジスト組成物として使用した場合にはアルカリ現像性、耐エッティング性が劣るため微細なレジストパターンを形成できないといった問題点があった。

【0007】また、不飽和基を導入する方法として、特開平6-136077号公報にジメチロールプロピオン酸とε-カプロラクトンとの反応物、有機ポリイソシアネート化合物及び水酸基含有(メタ)アクリレートを反

応させてなる放射線硬化性樹脂組成物が記載されている。しかしながら、上記した組成物をレジスト組成物として使用した場合にはアルカリ現像性、耐エッチング性等が劣るといった問題点があった。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記した問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の液状又は水系感光性組成物が、アルカリ現像性、耐エッチングレジスト性等に優れ、このものが微細なパターンを形成するなどの性能に優れることを見出し本発明を完成するに至った。

【0009】即ち、本発明は、

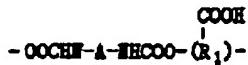
1、下記した構成単位

B-[X]_n[Y]_m-B

(式中、Xは式

【0010】

【化2】



【0011】及びYは-OOCHN-A-NHCOO-(R2)-で表され、Aはポリイソシアネート化合物に由来する構成単位、Bは同一もしくは異なってそれぞれの分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロキシ化合物に由来する構成単位及びR1はカルボキシル基含有ポリオール化合物に由来する構成単位、R2はポリオール化合物に由来する構成単位を示す。nは1～10整数及びmは1～10の整数を示す。X及び/又はYが2個以上の場合にはX及び/又はYは1個のものが相互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わない。)を有する光重合性ポリウレタン化合物及び必要に応じて上記した以外の光重合性化合物を含有することを特徴とする液状感光性組成物(以下、「本発明1」と略す。)、

2、上記の液状感光性組成物を分散してなることを特徴とする水系感光性組成物(以下、「本発明2」と略す。)、

3、(1)基材上に上記の感光性組成物を塗布して感光性被膜を形成する工程、(2)基材上に形成された感光性被膜表面に所望の被膜(画像)が得られるようにレーザー光線で直接もしくは光線を用いてネガマスクを通して感光し、硬化させる工程、(3)上記(2)工程で形成されたレジスト被膜をアルカリ現像処理して基板上にパターンを形成する工程、を含むパターン形成方法(以下、「本発明3」と略す。)に係わる。

【0012】

【発明の実施の形態】まず、本発明1～3で使用する光重合性ポリウレタン化合物について以下に説明する。

【0013】光重合性ポリウレタン化合物は、上記した式を有する化合物であって、それぞれの構成単位を形成するポリイソシアネート化合物、分子末端に1個以上の

光重合性不飽和基を有するヒドロキシ化合物、カルボキシル基含有ポリオール化合物、ポリオール化合物について説明する。

【0014】ポリイソシアネート化合物：該ポリイソシアネート化合物は分子中にカルボキシル基を導入する化合物と分子末端に光重合性不飽和基を導入する化合物とを結合させるために使用するものある。

【0015】脂肪族系ジイソシアネート化合物としては、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、1, 4-テトラメチレンジイソシアネート、ペントメチレンジイソシアネート、1,

10 2-プロピレンジイソシアネート、1, 2-ブチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネート、リジンジイソシアネート、2, 3-ブチレンジイソシアネート、1, 3-ブチレンジイソシアネート等、脂環式系ジイソシアネート化合物としては、例えば、イソホロンジイソシアネート、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、メチルシクロヘキサン-2, 4-(又は-2, 6-)ジイソシアネート、1, 3-(又は1, 4-

20 1)ジ(イソシアナトメチル)シクロヘキサン、1, 4-シクロヘキサンジイソシアネート、1, 3-シクロヘンタンジイソシアネート、1, 2-シクロヘキサンジイソシアネートなど；芳香族ジイソシアネート化合物としては、例えば、キシリレンジイソシアネート、メタキシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、1, 5-ナフタレンジイソシアネート、1, 4-ナフタレンジイソシアネート、4, 4'-トルイジンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルエーテルジイソシアネート、(m-又はp-)フェニレンジイソシアネート、4, 4'-ビフェニレンジイソシアネート、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ビフェニレンジイソシアネート、ビス(4-イソシアナトフェニル)スルホン、イソプロピリデンビス(4-フェニルイソシアネート)；その他のポリイソシアネート類としては、例えば、トリフェニルメタン-4, 4', 4"-トリイソシアネート、1, 3, 5-トリイソシアナトベンゼン、2, 4, 6-トリイソシアナトルエン、4, 4'-ジメチルジフェニルメタン-2, 2', 5, 5'-テトライソシアネートなどの3個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、1, 4-ブチレングリコール、ポリアルキレングリコール、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどのポリオールの水酸基に対してイソシアネート基が過剰量となる量のポリイソシアネート化合物を反応させてなる付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタン

30 30-40 30-40-トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどのポリオールの水酸基に対してイソシアネート基が過剰量となる量のポリイソシアネート化合物を反応させてなる付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタン-2, 2', 5, 5'-テトライソシアネートなどの3個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、1, 4-ブチレングリコール、ポリアルキレングリコール、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどのポリオールの水酸基に対してイソシアネート基が過剰量となる量のポリイソシアネート化合物を反応させてなる付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタン

50 50-50-トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどのポリオールの水酸基に対してイソシアネート基が過剰量となる量のポリイソシアネート化合物を反応させてなる付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタン

ジイソシアネート、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)などのビューレットタイプ付加物、イソシアヌル環タイプ付加物などが挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの化合物のなかでも、特に芳香族ジイソシアネート化合物はアルカリ現像液に対して加水分解し難くアルカリ性現像液やエッ칭ング液に対して抵抗力の大きな光硬化被膜を形成することができ、しかも被膜自体が強靭であることから、レジストパターン形成方法において光硬化したレジスト被膜を剥離するまでは、例えば、エッ칭ング液等の外力により基材から剥離しないで十分に付着するので好ましい。

【0016】分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するヒドロキシ化合物：該化合物は分子末端に光重合性不飽和基を導入するために使用する化合物である。

【0017】光重合性不飽和基としては、光によりラジカル重合反応して架橋構造を形成する不飽和基であり、従来から公知の不飽和基を包含する。該不飽和基の中でも特に(メタ)アクリロイル基が好ましい。

【0018】該化合物としては、2価以上の多価アルコール1モルに対して(メタ)アクリル酸等の不飽和酸が1モル以上が水酸基が残るように反応させたものが挙げられる。具体的には、例えば、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシメチル(メタ)アクリレート、(ポリ)エチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、(ポリ)プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールモノ(メタ)アクリレート等に1分子中に1個の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類：グリセリンジ(メタ)アクリレート、ジグリセリンジ(メタ)アクリレート、ジグリセリントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトール(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトルトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトルジ(メタ)アクリレート、ヒドロキシイソシアヌレートジ(メタ)アクリレート、ソルビトールジ(メタ)アクリレート等の1分子中に2個以上の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの中でも1分子中に2個以上の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類を使用することが好ましい。

【0019】カルボキシル基含有ポリオール化合物：該化合物は、分子中にカルボキシル基を導入することによりアルカリ現像処理により未照射レジスト被膜部の除去が可能となる成分である。

【0020】該化合物としては、分子中に1個以上のカルボキシル基と2個以上の水酸基を含有する化合物を使用することができる。具体的には、例えば、2, 2-ジメチロールプロピオン酸、2, 2-ジメチロール酢酸、

2, 2-ジメチロールペンタン酸、あるいは、トリオール化合物と酸無水物化合物の反応によって得られる半エステル化合物、ジメチルスルフォイソフタル酸ナトリウムとグリコール類をグリコール類過剰の条件下でエステル交換反応させることによって得られるスルフォネートジオール化合物等が挙げられ、これらの化合物は1種もしくは2種以上組み合わせて使用してもよい。

【0021】光重合性ポリウレタン化合物の上記した式において、nは1～10、特に1～5の範囲が好ましい。nが1未満になるとアルカリ現像処理が不可能となり、一方、nが10を超えるとレジスト感度等が悪くなる。通常、このものの数平均分子量は約1000～2000の範囲である。

【0022】ポリオール化合物：該化合物は、分子中にカルボキシル基を含まない疎水性基を分子主鎖中に導入することによりポリウレタン化合物に親水性と疎水性とのバランスを調製したり、またポリアルキレングリコール(数平均分子量約500～5000)等はそれ自体親水性を付与するものであるがこのものはレジスト被膜を柔軟にすることでアルカリ現像性や耐エッティング性等の被膜性能を向上させることができる。

【0023】該化合物としては、分子中に2個以上の水酸基を含有する化合物を使用することができる。具体的には、例えば、(ポリ)メチレングリコール、(ポリ)エチレングリコール、(ポリ)プロピレングリコール、1, 4-ブタンジオール、1, 3-ブタンジオール、2, 3-ブタンジオール、1, 2-ブタンジオール、3-メチル-1, 2-ブタンジオール、1, 2-ペンタンジオール、1, 5-ペンタンジオール、1, 4-ペンタンジオール、2, 4-ペンタンジオール、2, 3-ジメチルトリメチレングリコール、3-メチル-4, 3-ペンタンジオール、3-メチル-4, 5-ペンタンジオール、2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1, 5-ヘキサンジオール、1, 4-ヘキサンジオール、2, 5-ヘキサンジオール、1, 4-シクロヘキサンジメタノール、ネオペンチルグリコール、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン、グリセロール等が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの中でも1分子中に2個の水酸基を含有するヒドロキシ化合物を使用することが好ましい。

【0024】該光重合性ポリウレタン化合物は、一般的のポリウレタン樹脂と同様の公知の方法により製造することができる。即ち、カルボキシル基含有ポリオール化合物、ポリオール化合物とポリイソシアネート化合物との混合物をポリイソシアネート基が過剰(例えば、イソシアネート基/水酸基=約2.0～1.1モル比、好ましくは約2.0～1.2モル比)になるように配合したものをイソシアネート基と水酸基とを付加反応させて、カルボキシル基含有イソシアネート化合物を製造し、次い

でこのものに光重合性不飽和基含有ポリオール化合物を、例えば、イソシアネート基／水酸基=約0.8～1.0モル比、好ましくは約0.9～1.0モル比になるように配合したものを付加反応させることにより得られる。上記カルボキシル基は、反応させる前に、予め、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール等の低級アルコール等によりエステル化してブロックしておき、次いで反応後にこの低級アルコールを加熱により除去しカルボキシル基を再生することもできる。

【0025】イソシアネート基と水酸基との付加反応は、例えば、反応系の温度は通常50～150℃であるが、ラジカル重合性不飽和基の重合を防ぐため100℃以下が好ましく、必要に応じて、ウレタン化反応触媒を使用するとよい。ウレタン化反応触媒としては、オクチル酸スズ、ジブチルスズジラウレート等の有機錫化合物がある。

【0026】本発明1は、上記した光重合性ポリウレタン化合物及び必要に応じて上記した以外の光重合性化合物を含有する液状感光性組成物である。

【0027】必要に応じて使用できる光重合性化合物としては、1分子中に平均約1個以上、特に平均約1～10個の光重合性不飽和基を含有する重量平均分子量約100～80000、特に100～5000の範囲の従来から公知の不飽和モノマー類、不飽和樹脂（オリゴマー）等を使用することが好ましい。これらの光重合性化合物を配合することにより塗装粘度を調整したり、光硬化性、現像性等のレジスト被膜に要求される性能を改善することができる。光重合性不飽和基としては、光照射によりラジカル重合反応する基であれば特に制限なしに使用することができる。この光重合性不飽和基としては、例えばビニル基、（メタ）アクリロイル基、スチリル基やマレイン酸による基などが含まれる。

【0028】光重合性化合物としては、例えばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、n-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、tertブチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、n-オクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ドデシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシルカルビトール（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸のアルキル又はシクロアルキルエステルモノマー；メトキシブチル（メタ）アクリレート、メトキシエチル（メタ）アクリレート、エトキシブチル（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリリプロポキシ（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸のアルコキシアルキルエステルモノマー；スチレン、 α -メチルスチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニルモノマー；（メタ）アクリル

酸、マレイン酸等の α 、 β -エチレン性不飽和カルボン酸モノマー；ジメチルホスフェートエチルアクリレート、ジエチルホスフェートエチルアクリレートなどのアクリル磷酸エステルモノマー；グリジル（メタ）アクリレート、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル（メタ）アクリレート、グリジルエーテル等のエポキシ基含有不飽和モノマー；2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルア（メタ）アクリレート、3-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、（ポリ）アルキレングリコールモノアクリレート、及びこれらのモノマーとラクトン（例えば、 ε -カプロラクトン等）との付加物等の水酸基含有不飽和モノマー；ベンジル（メタ）アクリレート等の芳香族アルコールと（メタ）アクリル酸とのエステル；グリジル（メタ）アクリレート又は（メタ）アクリル酸のヒドロキシアルキルエステルとカプリン酸、ラウリン酸、リノール酸、オレイン酸等のモノカルボン酸化合物との付加物、（メタ）アクリル酸と「カージュラE10」（シェル化学社製）等のモノエポキシ化合物との付加物；エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル等の鎖状アルキルビニルエーテル；シクロペンチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、1,4-シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル等のシクロアルキルビニルエーテル；アリルグリジルエーテル、アリルエチルエーテル等のアリルエーテル；パーグルオロブチルエチル（メタ）アクリレート、パーグルオロイソノニルエチル（メタ）アクリレート、パーグルオロオクチルエチル（メタ）アクリレート等の弗素含有不飽和モノマー；（メタ）アクリロイルモルホリン、2-ビニルピリジン、1-ビニル-2-ピロリドン、ビニルカプロラクタム、ジメチル（メタ）アクリルアミド、N,N-ジメチルエチル（メタ）アクリレート、ダイアセトンアクリルアミド等の含窒素不飽和モノマー；エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラ以上のポリ（4～16）エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ブロピレングリコールジ（メタ）（アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリストリールテトラ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジイタコネート、エチレングリコールジマレート等の多価アルコール変性多官能モノマー；その他ハイドロキノンジ（メタ）アクリレート、レゾルシノールジ（メタ）アクリレート、ピロガロール（メタ）アクリレートなどを挙げることができる。また、上記の不飽和化合物は1種又は2種以上組合させて用いることができる。

【0029】上記した光重合性不飽和化合物以外に、例えばウレタン樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、スピラン樹脂、ポリエーテル樹脂、エポキシ樹脂などの樹脂に光重合性不飽和基が導入された樹脂も使用することができる。

【0030】上記した不飽和樹脂の代表例としては、例えばウレタン樹脂アクリレート、アクリル樹脂アクリレート、アクリル樹脂マレート、アルキド樹脂アクリレート、ポリエステル樹脂アクリレート、ポリエステル樹脂マレート、シリコーン樹脂アクリレート、フッ素樹脂アクリレート、スピラン樹脂アクリレート、ポリエーテル樹脂アクリレート、エポキシ樹脂アクリレートなどが挙げられる。

【0031】不飽和樹脂は、例えばウレタン樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポリエーテル樹脂などの水酸基含有樹脂と（メタ）アクリル酸、（無水）マレイン酸などの（無水）カルボキシル基含有不飽和化合物又はイソシアネートエチル（メタ）アクリレートなどのイソシアネート基含有不飽和化合物との反応物；ウレタン樹脂、アクリル樹脂などのイソシアネート基含有樹脂とヒドロキシエチル（メタ）アクリレートなどの水酸基含有不飽和モノマーとの反応物；アクリル樹脂（グリシジル（メタ）アクリレートのラジカル（共）重合体）、エポキシ樹脂（ビスフェノール／エピクロロヒドリンタイプ等）などのエポキシ基含有樹脂と（メタ）アクリル酸、マレイン酸などのカルボキシル基含有不飽和化合物との反応物などを使用することができる。これらの反応は従来から公知の方法で行うことができる。

【0032】不飽和樹脂の商品名としては、例えばN KエステルA-B P E-4（新中村化学工業（株）社製、商品名、エポキシアクリレート、重量平均分子量約512、不飽和度“分子量1000当たり重合性不飽和結合基の数、以下同様の意味を示す”約2）、アクチラン210TP30（日本シーベルヘグナー社製、商品名、ウレタンアクリレート、重量平均分子量約1900、不飽和度約1）、ビスコート井700（大阪有機化学工業（株）社製、商品名、ポリエーテルアクリレート、重量平均分子量約510、不飽和度約4）、紫光UV7510B（日本合成化学工業（株）社製、商品名、ウレタンアクリレート、重量平均分子量約4000、不飽和度0.75）、アロニックスM-110（東亞合成（株）社製、商品名、重量平均分子量310）、アロニックスM-305（東亞合成（株）社製、商品名、重量平均分子量298）、アロニックスM-101（東亞合成（株）社製、商品名、重量平均分子量236）、ビスコート井215（大阪有機合成化学工業（株）社製、商品名、重量平均分子量212、ネオペンチルグリコールジアクリレート）、カヤマーPM2（日本化薬（株）社

製、商品名、アクリル磷酸エステルモノマー）等が挙げられる。

【0033】その他の光重合性化合物の配合量は、目的に応じて適宜決めれば良いが、光重合性ポリウレタン化合物100重量部に対して、通常約0～200重量部、好ましくは約0～100重量部の範囲である。

【0034】本発明でいう光は、電子線、紫外線、可視光線等の活性エネルギー線を含有する。また、紫外線、可視光線を照射して架橋させる場合には、光重合開始剤及び必要に応じて光増感剤を配合することができる。

【0035】光ラジカル重合開始剤としては、従来から公知のものを使用することができる。このものとしては、例えば、ベンゾフェノン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルキサントン、チオキサントン、アントラキノンなどの芳香族カルボニル化合物；アセトフェノン、プロピオフェノン、 α -ヒドロキシイソブチルフェノン、 α , α' -ジクロル-4-フェノキシアセトフェノン、1-ヒドロキシ-1-シクロヘキシルアセトフェノン、ジアセチルアセトフェノン、アセトフェノンなどのアセトフェノン類；ベンゾイルパーオキサイド、 t -ブチルパーオキシー-2-エチルヘキサノエート、 t -ブチルハイドロパーオキサイド、ジ- t -ブチルジパーオキシイソフタレート、3, 3', 4, 4' - テトラ (t -ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノンなどの有機過酸化物；ジフェニルヨードブロマイド、ジフェニルヨードニウムクロライドなどのジフェニルハロニウム塩；四臭化炭素、クロロホルム、ヨードホルムなどの有機ハロゲン化物；3-フェニル-5-イソオキサゾロン、2, 4, 6-トリス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジンベンズアントロンなどの複素環式及び多環式化合物；2, 2'-アゾ(2, 4-ジメチルバレニトリル)、2, 2-アゾビスイソブチロニトリル、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)などのアゾ化合物；鉄-アレン錯体(ヨーロッパ特許152377号公報参照)；チタノセン化合物(特開昭63-221110号公報参照)、ビスイミダゾール系化合物；N-アリールグリシジル系化合物；アクリジン系化合物；芳香族ケトン／芳香族アミンの組み合わせ；ペルオキシケタール(特開平6-321895号公報参照)等が挙げられる。上記した光ラジカル重合開始剤の中でも、ジ- t -ブチルジパーオキシイソフタレート、3, 3', 4, 4' - テトラ (t -ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノン、鉄-アレン錯体及びチタノセン化合物は架橋もしくは重合に対して活性が高いのでこのものを使用することができる。

【0036】また、商品名としては、例えば、イルガキュア651(チバガイギー社製、商品名、アセトフェノン系光ラジカル重合開始剤)、イルガキュア184(チバガイギー社製、商品名、アセトフェノン系光ラジカル

重合開始剤)、イルガキュア1850(チバガイギー社製、商品名、アセトフェノン系光ラジカル重合開始剤)、イルガキュア907(チバガイギー社製、商品名、アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤)、イルガキュア369(チバガイギー社製、商品名、アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤)、ルシリンTPO(BASF社製、商品名、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド)、カヤキュアDETXS(日本化薬(株)社製、商品名)、CGI-784(チバガイギー社製、商品名、チタン錯体化合物)などが挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。

【0037】光増感色素としては、例えば、チオキサンテン系、キサンテン系、ケトン系、チオピリリウム塩系、ベーススチリル系、メロシアニン系、3-置換クマリン系、3,4-置換クマリン系、シアニン系、アクリジン系、チアジン系、フェノチアジン系、アントラセン系、コロネン系、ベンズアントラセン系、ペリレン系、メロシアニン系、ケトクマリン系、フマリン系、ボレート系、ユロリジン系等の色素が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。ボレート系光増感色素としては、例えば、特開平5-241338号公報、特開平7-5685号公報及び特開平7-225474号公報等に記載のものが挙げられる。

【0038】本発明の光重合性組成物には、必要に応じて、密着促進剤類、ハイドロキノン、2,6-ジ-*t*-ブチル-p-クレゾール、N,N-ジフェニル-p-フェニレンジアミン等の重合禁止剤類、上記以外の下記含窒素化合物、ゴム、飽和樹脂、不飽和基含有ビニル重合体等の有機樹脂微粒子、着色顔料、体质顔料等の各種顔料類、酸化コバルト等の金属酸化物類、フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、トリクレジルホスフェート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等の可塑剤、ハジキ防止剤、流動性調整剤等を含有することができる。

【0039】上記した密着促進剤類としては、基板に対する被膜の密着性を向上させるために配合するものであって、例えば、テトラゾール、1-フェニルテトラゾール、5-アミノテトラゾール、5-アミノ-1-メチルテトラゾール、5-アミノ-2-フェニルテトラゾール、5-メルカプト-1-フェニルテトラゾール、5-メルカプト-1-メチルテトラゾール、5-メチルチオテトラゾール、5-クロロ-1-フェニル-1H-テトラゾール等のトラゾール類を挙げることができる。これらのものは1種又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0040】含窒素化合物としては、画像の解像力を改善するために、例えば、特開平3-137176号公報に記載の含窒素化合物(c)、例えばベンゾトリアゾー

ル類、ピラゾール類等を配合することができる。これらは1種又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0041】飽和樹脂としては、感光性組成物の溶解性(レジスト被膜のアルカリ現像液に対する溶解性や光硬化被膜の除去で使用する例えば強アルカリ液に対する溶解性の抑制剤)を抑制するために使用することができる。このものとしては、例えば、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、(メタ)アクリル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、天然樹脂、合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリウレタン樹脂等が含まれる。これらの樹脂は1種又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0042】液状感光性組成物は、上記した液状感光性組成物を支持体(例えば、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、鉄などの金属またはそれらを成分とした合金のシート又はこれらの金属で表面処理したプリント基板、プラスチック、ガラス又はシリコーンウエハー、カーボンなど)にローラー、ロールコーティング、スピンドルコーティング、カーテンロールコーティング、スプレー、静電塗装、浸漬塗装、シルク印刷等の手段により塗布し、必要に応じてセッティングした後、乾燥することによりレジスト被膜を得ることができる。

【0043】また、レジスト被膜は光で露光し硬化させる前の材料表面に予めカバーコート層を設けておくことができる。このカバーコート層は空気中の酸素を遮断して露光によって発生したラジカルが酸素によって失活するのを防止し、露光による感光材料の硬化を円滑に進めるために形成されるものである。

【0044】このカバーコート層としては、例えば、ポリエチレンテレフタート等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂等の樹脂フィルム(膜厚約1~70μm)を塗装被膜表面に被せることにより、またポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニルの部分ケン化物、ポリビニルアルコール-酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニルの部分ケン化物-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロリドン、ブルラン等の水溶性多糖類ポリマー類、塩基性基、酸性基又は塩基を含有する、アクリル系樹脂、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂等の水性樹脂類を水に溶解もしくは分散した水性液を塗装被膜表面に塗装(乾燥膜厚約0.5~5μm)、乾燥することによりカバーコート層を形成することができる。このカバーコート層は感光材料表面を露光した後、現像処理される前に取り除くことが好ましい。この水溶性多糖類ポリマーや水性樹脂のカバーコート層は、例えばこれらの樹脂を溶解もしくは分散する水、酸性水溶液、塩基性水溶液等の溶媒により取り除くことができる。

【0045】該カバーコート層は、レジスト被膜上に塗装して形成してもよいし、レジスト被膜上に貼り付けて形成してもよい。カバーコート層は現像処理前に除去し

ても、又は除去しなくともどちらでも構わない。

【0046】光硬化に使用される光源としては、例えば、超高圧、高圧、中圧、低圧の水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライド灯、タンゲステン灯等が挙げられる。また、可視領域に発振線を持つ各種レーザーを使用することができる。なかでも、アルゴンレーザー(488 nm)又はYAG-SHGレーザー(532 nm)に発振線を持つレーザーが好ましい。

【0047】本発明の液状感光性組成物は、例えば、プラスチックシート、金属、ガラス、紙、木材等の基材に塗装、印刷を行うことができる。また、該組成物をレジストパターン被膜形成用として使用することが好ましい。

【0048】次に、この液状感光性組成物を使用し、基板上にレジストパターンを形成する方法(本発明3)について以下に述べる。

【0049】液状感光性組成物を基板上に塗装(1)して感光性被膜を形成し、塗装された感光性被膜表面に所望の被膜(画像)が得られるようにレーザー光で直接もしくは光線をネガマスクを通して露光(2)して硬化させ、次いで、アルカリの水溶液で感光性被膜の未硬化部分を現像処理(3)して基板上にレジスト被膜を形成させ、レジスト被膜で保護されていない部分の銅層を除去し、更にレジスト被膜を除去することにより得られる。

【0050】上記した基板としては、電気絶縁性のガラスエポキシ板、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリイミドフィルム等のプラスチックフィルムやプラスチック板；これらのプラスチック板やプラスチックフィルムの表面に銅、アルミニウム等の金属箔を接着することによって、もしくは銅、ニッケル、銀等の金属又は酸化インジウム一錫(ITO)に代表される導電性酸化物等の化合物を真空蒸着、化学蒸着、メッキ等の方法で導電性被膜を形成したもの：スルーホール部を設けたプラスチック板やプラスチックフィルムの表面及びスルーホール部に導電性被膜を形成したもの：銅板等の金属板等が挙げられる。

【0051】上記塗装(1)工程において液状感光性組成物を基板の表面にスプレー塗装、静電塗装、スピニ塗装、浸漬塗装、ローラー塗装、カーテンフロー塗装、シルク印刷等の手段により塗装し、必要に応じてセッティング等を行って、約50～130℃の範囲の温度で乾燥を行うことにより液状感光性被膜を形成することができる。このようにして形成された被膜は次いで工程(2)で露光されるが、必要に応じて該被膜表面に酸素を遮断し露光による感光性被膜の硬化の阻害を防止するために従来から公知の非感光性のカバーコート層を設けることができる。

【0052】露光工程(2)で使用する光線としては、特に光源の発光スペクトルの波長が488 nm(アルゴ

ンレーザー)又は532 nm(YAG-SHGレーザー)である可視光線が実用化されておりこのものを使用することが好ましいが、このものに限定されるものではない。

【0053】現像処理(3)は、未硬化被膜の洗い出しは、通常、苛性ソーダー、炭酸ソーダー、苛性カリ、アンモニア、アミン等を水に希釀した弱アルカリ水溶液が使用される。カバーコートが設けられている場合には現像処理前にこのカバーコートを取り除いておくことが好ましい。また、エッチングレジスト基板として使用する場合には、次いで露出した銅層(非回路部分)を塩化第2鉄や塩化第2銅の水溶液でエッチングすることにより除去される。また、レジスト被膜の除去は苛性ソーダ等の強アルカリや塩化メチレン等の溶剤により除去される。

【0054】このようにして得られるレジストパターンが形成された基板は、装飾用、ソルダーレジスト基板、エッチングレジスト基板として使用することができる。

【0055】本発明2は、上記した光重合性ポリウレタン化合物及び必要に応じて上記した以外の有機溶剤、及び光重合性化合物を含有する液状感光性組成物を水分散してなる水系感光性組成物である。

【0056】該液状感光性組成物の水溶化又は水分散化は、光重合性ポリウレタン化合物及び必要に応じて配合される光重合性化合物によるカルボキシル基をアルカリ(中和剤)で中和することによって行われる。

【0057】該感光性組成物中のカルボキシル基は、光重合性化合物の酸価で約30～700 mg KOH/g、特に約40～600 mg KOH/gの範囲のものが好ましい。酸価が約30を下回ると現像液の処理による未硬化被膜の脱膜性が劣るために次のエッチング行程で銅が充分に除去できないといった欠点があり、一方酸価が約700を上回るとレジスト被膜部(硬化被膜部)が脱膜し易くなるために満足できる銅回路が形成されないといった欠点があるので好ましくない。また、ソルダーレジストにおいては酸価が約30を下回ると現像液の処理による未硬化被膜の脱膜性が劣り、一方酸価が約700を上回るとレジスト被膜部(硬化被膜部)が脱膜し易くなるので好ましくない。

【0058】上記した有機溶剤としては、例えば、ケトン類、エステル類、エーテル類、セロソルブ類、芳香族炭化水素類、アルコール類、ハログン化炭化水素類などが挙げられる。

【0059】上記したアルカリ中和剤としては、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエチルアミン、ジエチルアミン、ジメチルアミノエタノール、シクロヘキシルアミン、アンモニア、苛性ソーダー、苛性カリなどが使用できる。中和剤の使用量は光重合性ポリウレタン化合物に含まれるカルボキシル基1当量当たり、一般に、0.2～1.0当量、特に0.3～

0. 8 当量が好ましい。

【0060】水系感光性組成物には、上記したと同様の光重合開始剤、光増感剤、密着促進剤類、ハイドロキノン、2、6-ジ-*t*-ブチル-p-クレゾール、N,N-ジフェニル-p-フェニレンジアミン等の重合禁止剤類、飽和樹脂、有機樹脂微粒子、着色顔料、体质顔料等の各種顔料類、酸化コバルト等の金属酸化物類、フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、トリクロレジルホスフェート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等の可塑剤、ハジキ防止剤、流動性調整剤等を含有することができる。

【0061】水系感光性組成物は、上記した水系感光性組成物を支持体（例えば、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、鉄などの金属またはそれらを成分とした合金のシート又はこれらの金属で表面処理したプリント基板、プラスチック、ガラス又はシリコーンウェハー、カーボンなど）にローラー、ロールコーティング機、スピンドルコーティング機、カーテンロールコーティング機、スプレー、静電塗装、浸漬塗装、シルク印刷等の上記したと同様の手段により塗布することによりレジスト被膜を得ることができる。

【0062】また、水系感光性組成物は上記した以外に電着塗料として使用することができる。

【0063】電着塗料は、例えば浴濃度（固形分濃度）3～25重量%、特に5～15重量%の範囲に調整した、PH4～7の範囲のカチオン電着塗料、PH7～9の範囲のアニオン電着塗料を使用することができる。

【0064】電着塗料は、例えば、次のようにして被塗物である導体表面に塗装することができる。即ち、まず、浴のPHと浴濃度を上記の範囲に調整し、浴温度を15℃～40℃、好ましくは15℃～30℃に管理する。次いで、このように管理された電着塗装浴に、塗装される導体を電着塗料がアニオン型の場合には陽極とし、また、カチオン型の場合には陰極として、浸漬、5～200Vの直流電流を通電する。通電時間は10秒～5分が適当である。

【0065】また、該電着塗装方法において、被塗物にガラス転移温度の低い電着塗料を塗装し、次いで水洗又は水洗乾燥後、更にガラス転移温度20℃以上の電着塗料を塗装する方法（特開平2-20873号公報参照）、即ちダブルコート電着塗装を行うこともできる。

【0066】得られる膜厚は乾燥膜厚で、一般に0.5～50μm、特に1～15μmの範囲が好ましい。

【0067】電着塗装後、電着浴から被塗物を引き上げ、水洗した後、電着塗膜中に含まれる水分等を熱風等で乾燥、除去する。導体としては、金属、カーボン、酸化錫等の導電性材料またはこれらを積層、メッキ等によりプラスチック、ガラス表面に固定させたものが使用できる。

【0068】また、可視光で露光し硬化させる前の電着

塗装被膜表面に予めカバーコート層を設けておくことができる。このカバーコート層としては、上記したものを持げることができる。このカバーコート層は電着塗装被膜が現像処理される前に取り除くことが好ましい。水溶性多糖類ポリマーや水性樹脂を使用したカバーコート層は、例えばこれらの樹脂を溶解もしくは分散する水、酸性水溶液、塩基性水溶液等の溶媒により取り除くことができる。

【0069】本発明の水系感光性組成物は、上記した以外に、例えば、ベースフィルム層となるポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂等の透明樹脂フィルム上に、本発明の組成物をロールコーティング、プレードコーティング、カーテンフローコーティング等を使用して塗布し、乾燥してレジスト被膜（乾燥膜厚約0.5～5μm）を形成した後、該被膜表面に保護フィルムを貼り付けたドライフィルムレジストとして使用することができる。

【0070】このようなドライフィルムレジストは、保護フィルムを剥離した後、レジスト被膜が面接するよう上記と同様の支持体に熱圧着させる等の方法で接着してレジスト被膜を形成することができる。得られたレジスト被膜は、ベースフィルム層を剥離するもしくは剥離を行わないで、次いで上記した電着塗膜と同様の方法で、画像に応じて、可視光で露光し、硬化させ、ベースフィルム層がある場合にはこのものを剥離し、ない場合にはこの上から現像処理することにより画像を形成することができる。また、ドライフィルムレジストにおいて、必要に応じてベースフィルム層とレジスト被膜との間に上記のカバーコート層を設けることができる。該カバーコート層は、レジスト被膜上に塗装して形成してもよいし、レジスト被膜上に貼り付けて形成してもよい。カバーコート層は現像処理前に除去しても、又は除去しなくともどちらでも構わない。

【0071】光硬化に使用される光源、カバーコートなどは上記したものと同様のものを使用することができる。

【0072】また、水系感光性組成物を使用し、基板上にレジストパターンを形成する方法は下記方法（本発明3）で行うことができる。

【0073】水系感光性組成物を基板上に塗装（1）して感光性被膜を形成し、塗装された感光性被膜表面に所望のレジスト被膜（画像）が得られるようにレーザー光で直接もしくは光線をネガマスクを通して露光（2）して硬化させ、次いで、アルカリの水溶液で感光性被膜の未硬化部分を現像処理（3）して基板上にレジスト被膜を形成させ、レジスト被膜で保護されていない部分の銅層を除去し、更にレジスト被膜を除去することにより得られる。

【0074】上記した基板としては、上記と同様のものが使用できる。

【0075】上記塗装(1)工程において水系感光性組成物を基板の表面にスプレー塗装、静電塗装、スピニ塗装、浸漬塗装、ローラー塗装、カーテンフロー塗装、シルク印刷、電着塗装等の手段により塗装し、必要に応じてセッティング等を行って、約50～130℃の範囲の温度で乾燥を行うことにより感光性レジスト被膜を形成することができる。このようにして形成された被膜は次いで工程(2)で露光されるが、必要に応じて該被膜表面に酸素を遮断し露光による感光性被膜の硬化の阻害を防止するために従来から公知の非感光性のカバーコート層を設けることができる。

【0076】また水系感光性組成物が、電着塗料の場合は、電着塗装した後、水切り、エアープロー等を行って、必要に応じて約50～130℃の範囲の温度で乾燥を行うことによりネガ型感光性樹脂被膜を形成することができる。

【0077】上記したネガ型感光性樹脂被膜の膜厚は約0.5～100μm、特に約1～50μmの範囲が好ましい。

【0078】露光工程(2)の光源は、上記と同様のものが使用できる。

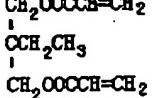
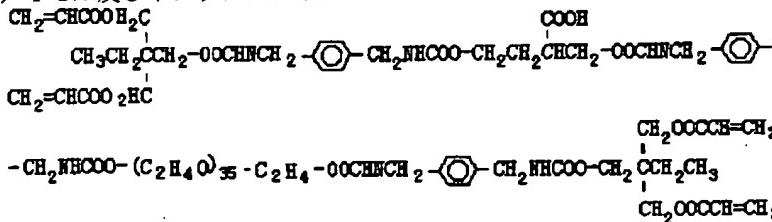
液状感光性組成物の製造

実施例1

光重合性ポリウレタン化合物A (*)	100部
重合開始剤 (**)	3部
増感剤 (***)	1.5部

上記した配合物を混合して実施例1の感光性組成物を得た。

【0083】(*) 光重合性ポリウレタン化合物A：ジメチロールブタン酸1モル、ポリエチレングリコール(数平均分子量200)1モル及びキシリレンジイソシ※



※アネット3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0084】
30 【化3】

【0085】(**) 重合開始剤：チタノセン化合物、商品名、CGI-784、チバガイキー社製

(***) 増感剤LS-1：クマリン系光増感剤、商品名、NKK-1595、日本感光色素社製

上記で得た感光性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、60℃で10分間乾燥し乾燥膜厚10μmのレジスト膜を得た。

【0086】上記レジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μ

10) 18
* 【0079】現像処理(3)において、未硬化被膜の洗い出しが、通常、苛性ソーダー、炭酸ソーダー、苛性カリ、アンモニア、アミン等を水に希釈した弱アルカリ水溶液が使用される。カバーコートが設けられている場合には現像処理前にこのカバーコートを取り除いておくことが好ましい。また、エッチングレジスト基板として使用する場合には、次いで露出した銅層(非回路部分)を塩化第2鉄や塩化第2銅の水溶液でエッチングすることにより除去される。また、レジスト被膜の除去は苛性ソーダ等の強アルカリや塩化メチレン等の溶剤により除去される。

【0080】このようにして得られるレジストパターンが形成された基板は、上記と同様に装飾用、ソルダーレジスト基板、エッチングレジスト基板として使用することができる。

【0081】

【実施例】実施例により本発明をさらに具体的に説明する。以下、「部」及び「%」は、それぞれ「重量部」及び「重量%」を意味する。

【0082】

*

100部
3部
1.5部

※アネット3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0084】
30 【化3】

m)) になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0087】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0088】実施例2

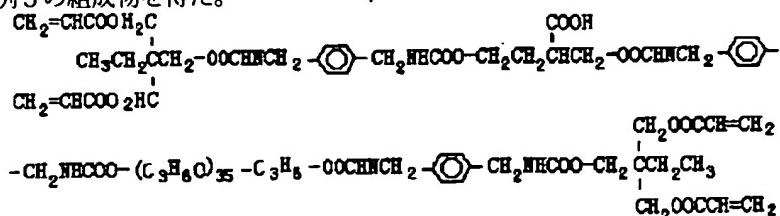
実施例1の組成物に光重合性ウレタン化合物A 50部に代えてテトラエチレングリコールジアクリレート50部を配合して実施例2の組成物を得た。このものを実施例

1と同様にしてレジスト被膜を形成した。その結果、アルカリ現像による解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。また、エッチングによる解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。

【0089】実施例3

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記光重合性ウレタン化合物Bを使用した以外は実施例1と同様に配合して実施例3の組成物を得た。

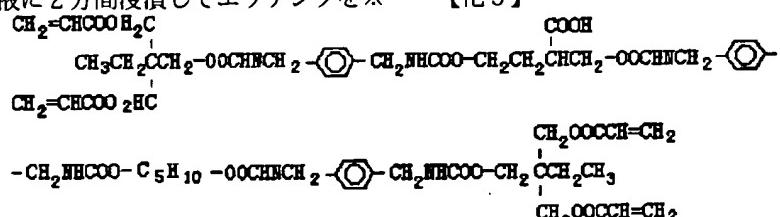
*



【0092】上記で得た感光性組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0093】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が 5 mJ/cm^2 となるように可視光レーザーを解像度 $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ （ライン（ μm ）／スペース（ μm ））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を 60°C で10分間加熱した後、 30°C の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。

【0094】アルカリ現像をおこなった後、 20°C 、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングを※



【0098】上記で得た感光性組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0099】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が 5 mJ/cm^2 となるように可視光レーザーを解像度 $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ （ライン（ μm ）／スペース（ μm ））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を 60°C で10分間加熱した後、3★

実施例5

光重合性ポリウレタン化合物A

重合開始剤A (****)

重合開始剤B (*****)

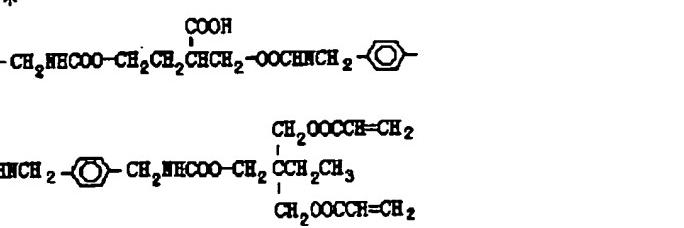
上記した配合物を混合して実施例5の感光性組成物を得た。

【0102】(****) 重合開始剤A：アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤、商品名、イルガキュア907、チバガイギー社製

* 【0090】(*) 光重合性ポリウレタン化合物B：ジメチロールブタン酸1モル、プロピレングリコール1モル及びキシリレンジイソシアネート3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0091】

【化4】



※おこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。

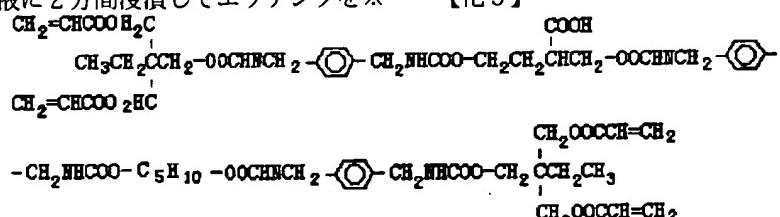
【0095】実施例4

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記光重合性ウレタン化合物Cを使用した以外は実施例1と同様に配合して実施例4の組成物を得た。

【0096】(*) 光重合性ポリウレタン化合物B：ジメチロールブタン酸1モル、1, 5-ペンタンジオール1モル及びキシリレンジイソシアネート3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0097】

【化5】



★ 0°C の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。

【0100】アルカリ現像をおこなった後、 20°C 、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は $100\text{ }\mu\text{m}/100\text{ }\mu\text{m}$ で良好であった。

【0101】

100部

10部

2部

(****) 重合開始剤B：チオキサントン系光ラジカル重合開始剤、商品名カヤキュアDETX-S、日本化薬社製

上記で得た感光性組成物を、表面に厚さ $18\text{ }\mu\text{m}$ の銅層50を有する、板厚2mm、大きさ $350 \times 460\text{ mm}$ の銅

張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、60°Cで10分間乾燥し乾燥膜厚10 μmのレジスト膜を得た。

【0103】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100 mJ/cm²となるようにまた、解像度100 μm/100 μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60°Cで10分間加熱して*た後、30°Cの1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して*

実施例6

光重合性ポリウレタン化合物A	100部
重合開始剤A (****)	5部
重合開始剤B (*****)	1部
フタロシアニングリーン	1部
タルク	50部
エポキシ樹脂 (*****)	20部

上記した配合物を分散、混合して実施例6の感光性組成物を得た。

【0106】(****)重合開始剤A：アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤、商品名、イルガキュア907、チバガイギー社製

(****)重合開始剤B：チオキサントン系光ラジカル重合開始剤、商品名カヤキュアDETX-S、日本化薬社製

(*****)エポキシ樹脂：ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂、商品名、エピコート828、油化シェル社製上記で得た感光性組成物を、表面に厚さ18 μmの銅層を有する、板厚2 mm、大きさ350×460 mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、80°Cで10分間乾燥し乾燥膜厚50 μmのレジスト膜を得た。

【0107】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100 mJ/cm²となるように、また、解像度100 μm/100 μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した後、30°Cの1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100 μm/100 μmで良好であった。

【0108】実施例7

実施例6の組成物にポリ（1～10）エチレングリコールジメタクリレート50部を配合して実施例7の組成物を得た。このものを実施例6と同様にしてレジスト被膜を形成した。その結果、アルカリ現像による解像度は100 μm/100 μmで良好であった。

【0109】比較例1

メチルメタクリレート40部、ブチルアクリレート40部、アクリル酸20部およびアゾビスイソブチロニトリル2部からなる混合液を、窒素ガス雰囲気下において110°Cに保持したプロピレングリコールモノメチルエーテル90部中に3時間をして滴下した。滴下終了後、

*アルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100 μm/100 μmで良好であった。

【0104】アルカリ現像をおこなった後、20°C、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッティングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100 μm/100 μmで良好であった。

【0105】

100部
5部
1部
1部
50部
20部

1時間熟成させ、アゾビスジメチルバレオニトリル1部及びプロピレングリコールモノメチルエーテル10部からなる混合液を1時間要して滴下し、さらに5時間熟成させて高酸価アクリル樹脂（樹脂酸価155 mg KOH/g）溶液を得た。次に、この溶液にグリシジルメタクリレート24部、ハイドロキノン0.12部およびテトラエチルアンモニウムプロマイド0.6部を加えて、空気を吹き込みながら110°Cで5時間反応させて固形分約55.4%の感光性樹脂溶液を得た。得られた樹脂は、樹脂酸価約50 mg KOH/g、数平均分子量約20,000であった。

【0110】実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて上記感光性樹脂溶液を同部（固形分換算）使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例1の組成物を得た。

【0111】上記で得た感光性組成物を、実施例1と同様にして感光性レジスト膜を得た。

【0112】得られたレジスト膜形成基板に、波長488 nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5 mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100 μm/100 μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60°Cで10分間加熱した後、30°Cの1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。

【0113】アルカリ現像をおこなった後、20°C、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッティング行ったが、途中で膜が剥離したため100 μm/100 μmの解像はできなかった。

【0114】比較例2

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記感光性樹脂溶液を同部（固形分換算）使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例2の組成物を得た。

【0115】感光性樹脂：ジメチロールプロピオン酸134部、 ϵ -カプロラクトン366部、塩化第一スズ0.15部を仕込み、110℃に加熱し、約10時間反応し、60℃まで冷却させ、次いでイソホロンジイソシアネート333.4部及び希釗剤として、ポリエチレンギリコールジアクリレート（日本化薬（株）製、KAYARAD PEG400DA）409.4部を仕込み、80℃で約10時間反応し、次いで2-ヒドロキシエチルアクリレート121.8部、p-メトキシフェノール0.6部を仕込み、80℃で約15時間反応され、ポリエチレンギリコールジアクリレート30%含有ウレタンアクリレートを得た。

【0116】上記で得た感光性組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0117】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去したが、十分な硬化膜を得ることができた。

【0118】比較例3

メチルメタクリレート40部、ブチルアクリレート40部、アクリル酸20部およびアゾビスイソブチロニトリル2部からなる混合液を、窒素ガス雰囲気下において110℃に保持したプロピレンギリコールモノメチルエーテル90部中に3時間を要して滴下した。滴下終了後、1時間熟成させ、アゾビスジメチルバレロニトリル1部及びプロピレンギリコールモノメチルエーテル10部からなる混合液を1時間要して滴下し、さらに5時間熟成させて高酸価アクリル樹脂（樹脂酸価155mg KOH/g）溶液を得た。次に、この溶液にグリジルメタクリレート24部、ハイドロキノン0.12部およびテトラエチルアンモニウムプロマイド0.6部を加えて、空気を吹き込みながら110℃で5時間反応させて固形分約55.4%の感光性樹脂溶液を得た。得られた樹脂は、樹脂酸価約50mg KOH/g、数平均分子量約20,000であった。

【0119】実施例6において光重合性ウレタン化合物Aに代えて上記感光性樹脂溶液を同部（固形分換算）使用した以外は実施例6と同様にして配合して比較例3の組成物を得た。

【0120】上記で得た感光性組成物を、実施例6と同様にして感光性ソルダーレジスト膜を得た。

【0121】上記で得た光重合性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、80℃で10分間乾燥し乾燥膜厚5

0μmのレジスト膜を得た。

【0122】上記レジスト膜形成基板に、超高压水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるように、また、解像度100μm/100μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、レジスト膜残りを生じ、100μm/100μmの解像はできなかった。

【0123】水性感光性組成物の製造

実施例8

実施例1の組成物にトリエチルアミン4.5部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例8の水性感光性組成物を得た。上記で得た水性感光性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、60℃で10分間乾燥し乾燥膜厚10μmのレジスト膜を得た。

【0124】上記レジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0125】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッティングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0126】実施例9

実施例2の組成物にトリエチルアミン5.7部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例9の水性感光性組成物を得た。

【0127】上記で得た水性感光性組成物を、実施例8と同様にしてレジスト膜を得た。

【0128】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm（ライン（μm）/スペース（μm））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0129】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッティングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0130】実施例10

実施例3の組成物にトリエチルアミン5.9部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例10の水性感光性組成物を得た。

【0131】上記で得た水性感光性組成物を、実施例8と同様にしてレジスト膜を得た。

【0132】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0133】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0134】実施例11

実施例4の組成物にトリエチルアミン5.7部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例11の水性感光性組成物を得た。

【0135】上記で得た水性感光性組成物を、実施例8と同様にしてレジスト膜を得た。

【0136】上記で得た水系感光性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化工ポキシ基板にバーコータにて塗布し、60℃で10分間乾燥し乾燥膜厚10μmのレジスト膜を得た。

【0137】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるようにまた、解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0138】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0139】実施例12

実施例5の組成物にトリエチルアミン4.5部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例12の水性感光性組成物を得た。

【0140】上記で得た水性感光性組成物を、実施例8と同様にしてレジスト膜を得た。

【0141】上記で得た水系感光性組成物を、表面に厚

さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化工ポキシ基板にバーコータにて塗布し、80℃で10分間乾燥し乾燥膜厚50μmのレジスト膜を得た。

【0142】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるように、また、解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0143】実施例13

実施例6の組成物にトリエチルアミン4.5部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例13の水性感光性組成物を得た。

【0144】上記で得た水性感光性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化工ポキシ基板にバーコータにて塗布し、80℃で10分間乾燥し乾燥膜厚50μmのレジスト膜を得た。

【0145】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるように、また、解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0146】実施例14

実施例7の組成物にトリエチルアミン5.7部を配合して中和させた後、水分散させて固形分20%の実施例14の水性感光性組成物を得た。

【0147】上記で得た水性感光性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化工ポキシ基板にバーコータにて塗布し、80℃で10分間乾燥し乾燥膜厚50μmのレジスト膜を得た。

【0148】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるように、また、解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0149】比較例4

実施例8において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記水系感光性組成物を同部(固形分換算)使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例4の組成物を得た。

【0150】水系感光性組成物：ポリエステルジオール334部((株)クラレ製ポリメチルペンタンアジペー

ト、数平均分子量2000)、グリセロールモノアクリレート24.3部、2,2-ジメチロールプロピオン酸44.7部、ハイドロキノンモノメチルエーテル0.52部、ジブチル錫ジラウレート0.26部を仕込み40℃とし、攪拌下、乾燥空気を吹き込みながら、次に、イソホロンジイソシアネート185部を添加し、80℃に加熱し、6時間反応させイソシアネート基含有量1.30重量%の中間体を得た。次に、2-ヒドロキシエチルアクリレート34.8部を添加し、80℃で15時間反応し、イソシアネート基含有量0.16重量%のラジカル重合性不飽和基および陰イオン性親水基含有ポリウレタン樹脂を得た。40℃に冷却後、トリエチルアミン33.7部を添加、攪拌し、均一になった後、50℃に加熱した脱イオン水1503部の入った5リットル4つ口プラスコに、上記樹脂溶液を加え水溶化を行った。次に、減圧下、脱溶媒(メチルエチルケトン)を行い、淡黄色透明の水溶性の感光性樹脂溶液を得た。この樹脂溶液の不揮発分は30重量%であった。

【0151】上記で得た水系感光性組成物を、実施例8と同様にしてレジスト膜を得た。

* 【0152】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去したが、十分な硬化膜を得ることができた。

10 【0153】

【発明の効果】本発明は、上記した構成を有することから(1)分子量分布が狭いのでアルカリ現像液による溶解性が均一で且つエッティング液に対する耐エッティング抵抗性が優れる、(2)カルボキシル基が樹脂中に確実に導入されるのでアルカリ現像液による溶解性が均一で且つエッティング液に対する耐エッティング抵抗性が優れる、(3)ポリウレタン結合を持つので被膜物性がよく、耐エッティング抵抗性が優れるので露光部の耐アルカリ現像性、耐エッティング性に優れるといった顕著な効果を発揮する。

*20

フロントページの続き

(72)発明者 木暮 英雄

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

(72)発明者 磯崎 理

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA00 AB15 AC08 AD01 BC51
BC62 BC66 BC85 BC86 EA04
FA07 FA10 FA17